

# КР1533ЛП16, КФ1533ЛП16, ЭКФ1533ЛП16

Микросхемы представляют собой шесть повторителей с повышенной нагрузочной способностью. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1, 3, 5, 9, 11, 13 — информационные входы 1D...6D; 2, 4, 6, 8, 10, 12 — выходы 1Y...6Y; 7 — общий; 14 — напряжение питания.

## Электрические параметры



Условное графическое обозначение КР1533ЛП16, КФ1533ЛП16, ЭКФ1533ЛП16

Номинальное напряжение питания ..... 5 В ±10%  
Выходное напряжение низкого уровня при  $I_{\text{ВЫХ}}^0 = 24$  мА ..... ≤ 0,5 В  
Выходное напряжение высокого уровня при  $I_{\text{ВЫХ}}^0 = -15$  мА ..... ≥ 2 В  
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде ... ≤ | -1,5 | В  
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения при  $U_{\text{П}} = 5,5$  В .. ≤ 5 мА

Ток потребления при низком уровне выходного напряжения при  $U_{\text{П}} = 5,5$  В ..... ≤ 10,6 мА  
Входной ток низкого уровня ..... ≤ | -0,1 | мА  
Входной ток высокого уровня ..... ≤ 20 мкА  
Выходной ток ..... | -30 | ... | -112 | мА  
Время задержки распространения сигнала при включении (выключении) ..... ≤ 8 нс  
Емкость входа ..... ≤ 5 пФ

## Предельно допустимые режимы эксплуатации КР1533

Напряжение питания ..... 4,5...5,5 В  
Входное напряжение низкого уровня ..... 0...0,8 В  
Входное напряжение высокого уровня ..... 2...5,5 В  
Максимальное напряжение, подаваемое на выход . 5,5 В  
Температура окружающей среды ..... -10...+70 °С

## **Общие рекомендации по применению КР1533, КФ1533**

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930–76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270° С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.